

# 修复数据

正常人的开口度为3.7~4.5cm，开口型：正面观直向下。  
下颌最大侧方运动范围约为12mm。前伸最大运动范围：8-10mm。

拔牙3个月——修复治疗

拔牙1-2周——过渡修复

- I 度松动，牙槽骨吸收不超过根长1/3---可固定修复
- II 度松动，牙槽骨吸收不超过根长1/2---可活动义齿修复
- III 度松动，牙槽骨吸收达到根2 / 3以上 ---拔除

牙槽骨修整术：一般在拔牙后1个月左右修整较好。

接触区：5和6：颊1/3与中1/3交界处；6和7：中1/3

龈下边缘位于龈下0.5mm，距龈沟底至少0.5mm.

修复体聚合度 $2-5^{\circ}$ （嵌体外展）

粘结剂厚度 $\leq 30\mu\text{m}$ （冠边缘与颈缘之间的间隙不超过50微米）

嵌体深度  $> 2\text{mm}$

嵌体洞缘斜面 $45^{\circ}$ ，0.5-1mm宽

## 打桩时机总结：

- 1.牙髓正常、根尖无炎症根疗：3天
- 2.外伤、根尖炎根疗：1周
- 3.根尖炎症手术后：2周
- 4.有瘘管的患牙需在治愈后进行修复
- 5.根尖病变较广泛：病变明显缩小，形成骨硬板时且无症状

高嵌体合面1mm；钉洞4个，深2mm，直径1mm

前牙3/4冠邻沟平行唇面切2/3，位置：唇1/3与中1/3交界处

后牙3/4冠邻沟平行轴壁，位置：颊1/3与中1/3交界处

邻沟深：前牙深1mm；后牙 $\geq$ 1mm

切沟宽1mm，深0.5mm

合沟1.5mm

金属全冠备牙：合面1mm，肩台贵金属0.35-0.5mm，非贵金属0.5-0.8mm

烤瓷全冠备牙：切缘1.5-2mm（后牙合面2mm）

唇颊面1-1.5mm，肩台在龈下0.5-0.8mm，宽1mm

基底冠0.3-0.5mm

遮色瓷：0.2mm，不少于0.3mm

-6

金瓷结合：热膨胀系数：金 > 瓷（略大于） $(0.9-1.5) \times 10$

熔点：金 > 瓷（远大于） $170-270^{\circ}\text{C}$

桩核冠桩长三要求：

根尖封闭 $\geq 4\text{mm}$

桩长 $\geq$ 临床牙冠高度

骨内桩长 $\geq$ 骨内根长

桩直径：根径 $1/4-1/3$

牙本质肩领 $\geq 1.5\text{mm}$ ，宽 $1\text{mm}$

基牙倾斜度 $\leq 30^\circ$

固定义齿年龄20-60岁

牙周储备力是最大合力的1/2。

天然牙牙槽骨吸收1/4时，牙周膜面积通常丧失约30%。

上颌牙周膜面积排序：6、7、3、4、5、1、2

下颌牙周膜面积排序：6、7、3、5、4、2、1

牙周膜面积最小的---下1



基牙冠根比：理想1：2或2：3。最低1：1

基牙牙周要求：牙槽骨吸收 $\leq 1/3$ ，松动 $\leq 1$ 度

悬空式龈端距离粘膜 $> 3\text{mm}$

桥体减颊舌径，至天然牙的 $2/3 \sim 1/2$ 。（基牙条件差，最低减小至 $1/2$ ）

缺一牙恢复90%，缺两牙恢复75%，缺三牙50%。

固定连接体面积 $4-10\text{mm}^2$

固定连接体位置：前牙邻面中 $1/3$ 偏舌侧；后牙邻面中 $1/3$ 偏合方

常用倒凹深度 $<1\text{mm}$ ，倒凹坡度 $>20^\circ$

弯制 $0.75\text{mm}$ ；铸造金合金 $0.5\text{mm}$ ；铸造钴铬合金 $0.25\text{mm}$

解剖式牙尖 $30-33^\circ$ ，半解剖式 $20^\circ$ ，非解剖式 $0^\circ$

塑料基托厚 $2\text{mm}$ ，金属基托厚 $0.5\text{mm}$

可摘局部义齿基托盖磨牙后垫 $1/3-1/2$ （全口 $1/2-全部$ ）

合支托厚1-1.5mm

合支托与基牙长轴垂直；与基牙长轴垂线成正20°或10°

合支托大小：磨牙近远中径1/4，颊舌径1/3

前磨牙近远中径1/3，颊舌径1/2

杆设计：距龈缘3mm水平向前，成直角进入基牙的颊侧倒凹区（颈1/3），  
进入倒凹深度0.25mm，杆的末端2mm与牙面接触。

前腭杆距离龈缘至少6mm,侧腭杆4-6mm

舌杆厚：上缘1mm，下缘2mm.距离龈缘3-4mm。舌杆宽度3-4mm

斜坡型舌杆缓冲0.3-0.4mm

隙卡沟深度弯制1mm，铸造1.5mm

可摘局部义齿托盘：宽：3-4mm，高：距离粘膜转折2mm

弯制所需钢丝：前牙—0.8；前磨牙—0.9；磨牙--1.0；合支托—1.2

固位体（基牙）数：2-4个

种植成功标准：植入1年后年均骨吸收<0.2mm

拔牙后牙槽骨吸收速度变化：前3个月最快，6个月速度下降，2年稳定

(0.5mm)

全口义齿3-4年需调磨重衬，7-8年需重做。

承托面积：上颌是下颌的1.8倍，吸收速率：下颌是上颌的3-4倍

上颌1唇面距离切牙乳突中点8-10mm，增龄性后移

上颌3牙尖顶连线过切牙乳突中点

上颌3唇面距离腭皱侧面 $10.5 \pm 1$ mm

上前牙切缘在唇下露出2mm

后堤区位于颤动线前5mm内，宽2-12mm，平均8.2mm，模型上修整深度1-1.5mm

下颌基托盖磨牙后垫1/2-全部（可摘盖1/3-1/2）

下颌6合面与磨牙后垫1/2等高

种植覆盖全口义齿植入种植体6-8枚

上颌至少4个，下颌至少2个

种植覆盖全口义齿悬臂<14mm，基托距离牙槽嵴顶2mm

全口义齿选择托盘，水平向比牙槽嵴宽2-3mm（可摘3-4mm），高度比粘膜转折短2mm，后缘上颌盖过颤动线3-4mm，下颌盖过磨牙后垫

模型要求：边缘3-5mm，厚度至少10mm，腭小凹后2mm

上下牙槽嵴连线明显小于 $80^{\circ}$ 要排成反合

上颌合平面在上唇下缘2mm

微笑时唇高线露出上切牙 $2/3$ ，唇低线露出下切牙 $1/2$

排牙规律：颈部远中倾斜

上：2 > 3 > 1

谁与he平面接触？  
下：2 > 2 > 1

上颌—1切缘、

3牙尖、

4颊尖、

5颊舌两尖、

6近舌尖





